

BGA900D

紅外線 BGA 返修系統

精準控溫 · 穩定返修 · 高效維修



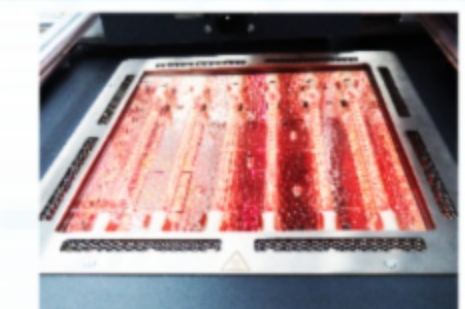
紅外線精準控溫

非接觸式紅外線測溫技術
測溫範圍0~300°C
精準監控返修溫度



上下加熱配置

頂部紅外線加熱搭配
底部預熱，提供均勻熱分布，
適用各種製程要求。



可調式PCB支架

X、Y軸靈活調整
適用各種PCB尺寸，
操作定位精準方便。



工藝流程控制

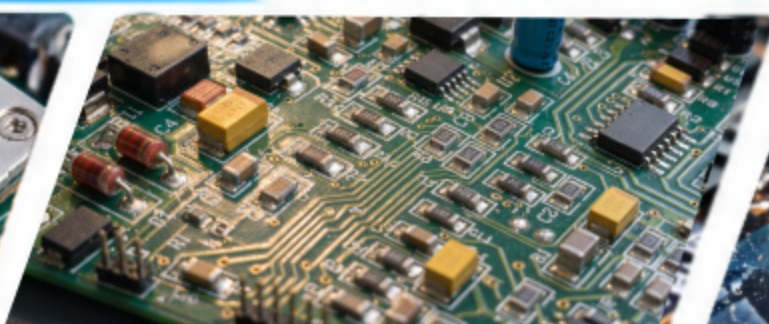
可設定溫度曲線與加熱時間，
支援 RS-232 電腦連線，
滿足各種返修工藝需求。



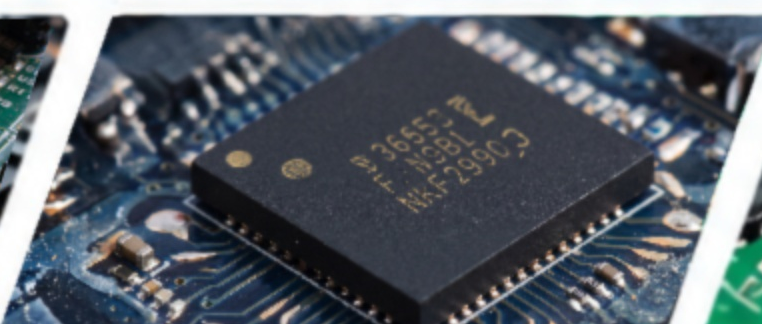
應用領域



BGA 拆焊/焊接



各類表面黏著零件維修



QFN維修



QFP維修

應用規格

產品型號	BGA 900D
設備類型	紅外線BGA返修設備
總功率	3200W (max)
底部預熱功率	2400 W (發熱管)
頂部預熱功率	720W(紅外發熱盤，波長約2~8μm)
頂部加熱尺寸	60 X60 mm (最大)
底部預熱區域	232x232 mm
最大PCB尺寸	420 X 400 mm
最大BGA尺寸	60 X 60 mm
紅外線測溫範圍	0 ~ 300°C
通訊介面	RS-232(可與PC聯機)
電源	220VAC
外型尺寸	816x608x516 mm (W X D X H)
淨重	36kg



3200 W

最大總功率



420×400mm

最大PCB尺寸



60×60mm

最大BGA尺寸



0 ~ 300°C

紅外線測溫範圍

軟體控制(選配)

可透過IR Soft 進行溫度曲線設定、
工藝流程控制與數據紀錄，
支援 RS-232 與 PC 連線

